

ARECプラザ 第111回リレー講演会

精密機械・産業用ロボット分野

日時：2010年4月15日(木) 15:00～18:00

終了後、交流会 [参加費：無料]

場所：AREC (上田市産学官連携支援施設) 4階

(上田市常田 3-15-1 信州大学繊維学部内 Tel: 0268-21-4377)

講演1

15:00～15:55

演題 『半導体後工程設備の世代別搬送システム改善について』

講師 アピックヤマダ株式会社 技術事業部 装置技術ブロック AE 技術 シニアマネージャー 内山 茂行 氏

講演概要 近年半導体パッケージは、組込み機器の小型化のため軽薄短小化が求められている。このため半導体組立設備は、リードフレームベースの物から有機基板へと展開され、設備形態が様変わりしている。今回、当社にて開発した世代別設備の特徴と、搬送システムに求められている高速・高頻度・高精度・安価な位置決め方法について、開発状況を交え紹介する。

講演2

16:00～16:50

演題 『ミシン針製造設備開発の取り組み』

講師 オルガン針株式会社 技術開発本部 設備開発部 設備開発課 設備設計係 係長 巖 福明 氏

講演概要 製造設備のほとんどが自社製である当社にとって、既存の熟練技能に依存する設備から、熟練工を頼らない設備の開発は急務になっている。針作りに必要な塑性加工、切削加工などの工程を集約した生産設備開発の取り組みについて紹介する。

休憩 10分

講演3

17:00～17:50

演題 『精密位置決め技術の動向と高度化への試み』

講師 信州大学 工学部 機械システム工学科 教授 深田 茂生 氏

講演概要 精密位置決め技術は、工作機械や半導体製造装置などの性能を支配する基盤技術の一つであり、あらゆる機械システムにおける機能の高度化と情報の高密度化を支えています。本講では、ナノメートルレベルの加工・測定を可能にする精密・超精密位置決め技術の動向について概説し、さらなる高度化をめざした新たな試みについて紹介する。

お申込先

ARECプラザ宛 メール (mousikomi@arecplaza.jp) またはファックス (0268-21-4382) でお申し込みください。

ARECプラザ 第111回リレー講演会 参加申込書		[平成22年4月15日(木)]	
企業・機関名			
参加者名			
所属・役職	電話番号		
メールアドレス	ファックス番号		

ご記入いただいた個人情報(御社名、所属・役職、氏名)は参加者名簿として、講演会参加者の方々に配布する予定です。